

Sync SRAM Code Information(1/3)

Last Updated : Dec. 2004

K **7** X X X X X X X X - X X X X X X X
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Memory (K)

2. Sync SRAM : 7

3. Small Classification

A : Sync Pipelined Burst

B : Sync Burst

C : Custom Product

D : Double Data Rate

E : Double Data Rate 3-Clk Align

H : Double Data Rate I-Common I/O

I : Double Data Rate II-Common I/O

J : Double Data Rate-Seperate I/O

L : Late Select

M : Sync Burst + NtRAM

N : Sync Pipelined Burst + NtRAM

P : Sync Pipe

Q : Quad Data Rate I

R : Quad Data Rate II

U : CSRAM

Z : DLW RAM

4~5. Density

10 : 1M

16 : 16M

20 : 2M

32 : 32M

40 : 4M

44 : 144M

64 : 64M

72 : 72M

80 : 8M

88 : 288M

6~7. Organization

08 : x8

09 : x9

18 : x18

32 : x32

36 : x36

44 : x144

72 : x72

8~9. Vcc, Interface, Mode

00 : 3.3V, LVTTL, 2E1D WIDE

01 : 3.3V, LVTTL, 2E2D WIDE

08 : 3.3V, LVTTL, 2E2D Hi SPEED

09 : 3.3V, LVTTL, Hi SPEED

11 : 3.3V, HSTL, R-R

12 : 3.3V, HSTL, R-L

14 : 3.3V, HSTL, R-R Fixed ZQ

22 : 3.3V, LVTTL, R-R

23 : 3.3V, LVTTL, R-L

25 : 3.3V, LVTTL, SB-FT WIDE

30 : 2.5/ 3.3V, LVTTL, 2E1D

31 : 2.5/ 3.3V, LVTTL, 2E2D

35 : 2.5/ 3.3V, LVTTL, SB-FT

44 : 2.5V, LVTTL, 2E1D

45 : 2.5V, LVTTL, 2E2D

49 : 2.5V, LVTTL, Hi SPEED

52 : 2.5V, HSTL, Burst2

54 : 2.5V, HSTL, Burst4

62 : 2.5V/ 1.8V, HSTL, Burst2

64 : 2.5V/ 1.8V, HSTL, Burst4

66 : 2.5V, HSTL, R-R

70 : 2.5V, HSTL, 4-1-1-1

71 : 2.5V, HSTL, 3-1-1-1

73 : 1.5V/ 1.8V, HSTL, All

74 : 1.8V/ 2.5V, HSTL, All

80 : 1.8V, LVCMOS, 2E1D

82 : 1.8V, HSTL, Burst2

84 : 1.8V, HSTL, Burst4

85 : 1.8V, LVCMOS, 2E2D, Hi SPEED

88 : 1.8V, HSTL, R-R

91 : 1.5V, HSTL, All

95 : 1.0V, HSTL, All

96 : 1.1V, HSTL, All

Sync SRAM Code Information(2/3)

Last Updated : Dec. 2004

K 7 X X X X X X X X - X X X X X X X
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10. Generation

- M : 1st Generation
- A : 2nd Generation
- B : 3rd Generation
- C : 4th Generation
- D : 5th Generation
- Z : TEMPORARY CODE

11. "—"

12. Package

- H : BGA, FCBGA, PBGA
- G : BGA, FCBGA, PBGA(LF)
- E : FBGA(LF) F : FBGA
- P : (L)QFP(LF) Q : (L)QFP
- C : CHIP BIZ W : WAFER

13. Temp, Power

- COMMON (Temp, Power)
- 0 : NONE,NONE (Containing of Error handling code)
- A : Automotive, Normal
- B : Commercial, Low Low
- C : Commercial, Normal
- E : Extended, Normal
- I : Industrial, Normal
- WAFER, CHIP BIZ Level Division
- 0 : NONE, NONE
- 1 : Hot DC sort
- 2 : Hot DC, selected AC sort

14~15. Speed

- Sync Burst, Sync Burst + NtRAM
 & < Mode is R-L >(Clock Accesss Time)
- 10 : 10ns(Sync Burst, Sync Burst + NtRAM)
- 38 : 3.8ns 43 : 4.3ns
- 48 : 4.8ns 50 : 5ns
- 55 : 5.5ns 60 : 6ns
- 65 : 6.5ns 67 : 6.7ns
- 70 : 7ns 75 : 7.5ns
- 80 : 8ns 85 : 8.5ns
- 90 : 9ns
- Other Small Classification (Clock Cycle Time)
- 10 : 100MHz 11 : 117MHz
- 13 : 133MHz 14 : 138MHz
- 15 : 150MHz 16 : 166MHz
- 17 : 175MHz 18 : 183MHz
- 19 : 143MHz 20 : 200MHz
- 21 : 200MHz(2.0ns) 22 : 225MHz
- 25 : 250MHz
- 26 : 250MHz(1.75ns) 27 : 275MHz
- 30 : 300MHz 31 : 312MHz
- 33 : 333MHz 35 : 350MHz
- 36 : 366MHz(t-CYCLE) 37 : 375MHz
- 40 : 400MHz(t-CYCLE) 42 : 425MHz
- 45 : 450MHz
- 50 : 500MHz(except Sync Pipe)
- 6A : 600MHz
- 6F : 650Mhz(Only CSRAM)
- 7F : 750MHz
- Sync SRAM COMMON
- 00 : NONE (Wafer, CHIP BIZ)

Sync SRAM Code Information(3/3)

Last Updated : Dec. 2004

K 7 X X X X X X X X - X X X X X X X X
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16. Packing Type

- Common to all products, except of Mask ROM
- Divided into TAPE & REEL(In Mask ROM, divided into TRAY, AMMO Packing Separately)

| Divide | Packing Type | New Marking |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| Component | TAPE & REEL | T |
| | Other (Tray, Tube, Jar) | 0 (Number) |
| | Stack | S |
| Component (Mask ROM) | TRAY | Y |
| | AMMO PACKING | A |
| Module | MODULE TAPE & REEL | P |
| | MODULE Other Packing | M |

17~18. Customer "Customer List Reference"